

[illegible]

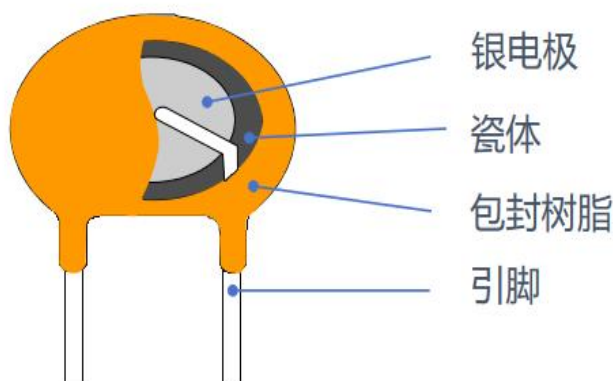
1

■ 电子元器件用银表面电极浆料

◆ 特征：

- * 银灰色膏状流体，主要由银粉、玻璃粉和有机粘合剂组成，不含铅、隔、铬等有害物质，符合 Rohs 环保要求。
- * 烧结后与瓷体结合紧密，附着力高，银层致密，导电率高。
- * 应用于电子元器件的银表面电极制造。

◆ 产品在电子元器件中应用示意图及产品图片



◆ 物理性能：

型 号	固含量 (%)	粘 度* (Pa·S)	细度 (第二刻线/90%)	适用性
MOV-1368	73.0±2.0	30~50	≤25 μm	氧化锌压敏电阻器
MOV-1160	67.2±1.5	30~50	≤25 μm	氧化锌压敏电阻器
MOV-1366A	71.8±1.0	35~55	≤25 μm	氧化锌压敏电阻器
MOV-1370E	74.5±1.5	30~50	≤25 μm	氧化锌压敏电阻器
MOV-1375	77.5±1.5	30~60	≤25 μm	氧化锌压敏电阻器
MOV-1160A	67.2±1.5	30~50	≤25 μm	NTC 热敏电阻器
SGT-9160	64.5±1.5	26~68	≤25 μm	瓷介电容器
SGT-8152	56.5±1.5	30~42	≤25 μm	蜂鸣片
SGT-8075	78.5±1.5	30~42	≤25 μm	滤波器、换能片

(注*：粘度检测条件为 Brookfield HBDV-II +, CP52, 10.0rpm, 25±0.5℃)

◆ 产品特点：

*该浆料所用关键材料银金属粉体为我司自制，可以接受客户定制不同银含量浆料。

◆ **推荐工艺：**

- * 搅 拌：使用前慢速搅拌均匀。
- * 丝 印：200~300 目不锈钢丝网或尼龙丝网。
- * 烧 结：推荐峰值温度及保温时间如下：

型号	烧结温度范围 (°C)	保温时间 (min)
MOV-1368	550±50	10~20
MOV-1160	550±50	10~20
MOV-1366A	550±50	10~20
MOV-1370E	550±50	10~20
MOV-1375	550±50	10~20
MOV-1160A	550±50	10~20
SGT-9160	815±10	8~15
SGT-8152	800±20	8~15
SGT-8075	800±20	8~15

◆ **产品使用注意事项**

- * 清 洗： 建议使用无水乙醇清洗。
- * 储存条件： 建议在温度 18~25℃、湿度≤75%环境密封储存，避免置于阳光直射或含有腐蚀性气体环境中。
- * 有 效 期： 建议在符合上述储存条件下 6 个月内使用。
- * 包装规范： 采用 PE 塑料瓶，500g/瓶或 1000g/瓶或 2000g/瓶。